



**BUSINESS  
REPORT 2012**

**FUJIMI**

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

# 社長あいさつ

## 今期から3年は「まいた種をきちんと育てる」期間とします

当社グループを取り巻く環境は、欧州の債務問題を背景とした景気低迷、緩慢な米国景気の状態や新興国の景気減速感、日本においては東日本大震災などにより全般的に停滞感が強く、先行きについても依然として不透明な状況が続いています。

半導体市場は、一般消費者向けを中心としたパソコン等の最終製品の需要が減速したことに加え、昨年10月に発生したタイ国の大洪水が世界的に電子関連産業の生産活動を阻害したことにより軟調に推移しました。

こうした状況の下、当社グループでは一丸となって売上の拡大を図るとともに、コスト削減に努めたものの、当連結会計年度の業績は、売上高27,424百万円（前期比11.2%減）、うち製品売上高27,114百万円（前期比10.8%減）となりました。また、利益面では、営業利益953百万円（前期比65.7%減）、経常利益1,038百万円（前期比63.2%減）、当期純利益543百万円（前期比70.2%減）となりました。

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、東日本大震災の影響等によりラッピング材の売上高は2,960百万円（前期比20.4%減）、ポリシング材の売上高は6,947百万円（前期比8.5%減）となりました。

CMP向け製品につきましては、デバイスメーカーへの出荷が減少し、売上高は8,029百万円（前期比5.9%減）となりました。

ハードディスク向け製品につきましては、従来型パソコンの低調な出荷状況やタイ国の大洪水による影響などから、

売上高は1,788百万円（前期比33.5%減）となりました。

今期の見通しにつきましては、半導体業界で足許復調の兆しがあり今後の需要回復が見込まれること、また、非半導体関連の新規需要が見込まれることから、業績面で相応な回復があるものと想定しています。

中長期経営計画3年目の当期は、新たな成長に向けての「基礎体力づくり」・「種まき」と位置づけた9年の中長期経営計画の第一期の最後の年でした。営業と開発の一体化、品質保証本部の再編、プロダクトサポート室の創設など市場やお客様のニーズにより迅速かつ的確にお応えできるよう組織を再編しました。

また、成長のために不可欠な人材育成として人事教育制度改革プロジェクトを推進し、次の事業の柱の発掘・育成として新規事業創出プロジェクトに注力した結果、芽が出つつある用途もあります。

引き続き、当社が理想とする『強く、やさしく、面白い』会社の実現を目指して、今期から3年は「まいた種をきちんと育てる」期間とし、中長期経営計画のステップである基盤強化を図ってまいります。

2012年7月  
代表取締役社長

## 関 敬史

## プロフィール

フジインコーポレーテッドは、1950年の創業以来、分級技術などを活かした精密人造研磨材メーカーとして独自の歩みを続けてきました。蓄積されたノウハウと研究開発から生まれた製品の数々は、光学レンズ用研磨材から出発し、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、コンピュータ用ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっています。最近では、耐衝撃性を飛躍的に高めたサーメット溶射材やCO<sub>2</sub>削減・省エネで注目されているLED用サファイア基板向け研磨材の商品化で新分野を開拓しています。

## 目次

社長あいさつ	1
当社の経営方針	3
研究開発活動	7
経営指標*	9
貸借対照表*	13
損益計算書*	15
キャッシュ・フロー計算書*	16
会社データ	17
株式情報	18

\*連結での数値を記載してあります。

# Message from the President

**We will commence the second three-year phase of our plan, to "raise the seeds we have planted."**

During the year, the global economy was characterized by economic sluggishness in Europe stemming from the debt crisis, slower growth in the United States and deceleration in emerging markets. The Japanese economy also experienced a marked sense of stagnation in the aftermath of the Great East Japan Earthquake. Accordingly, the economic outlook remained difficult to judge.

The semiconductor market was soft, as general consumer demand for final products such as personal computers decreased. Furthermore, flooding in Thailand in October 2011 disrupted production by the world's electronics manufacturers.

In this environment, the Fujimi Group put forth every effort to boost sales and reduce costs. Nevertheless, consolidated net sales fell 11.2% year on year, to ¥27,424 million. Of this amount, product sales accounted for ¥27,114 million, down 10.8%. On the profit front, operating income dropped 65.7%, to ¥953 million; ordinary income decreased 63.2%, to ¥1,038 million; and net income decreased 70.2%, to ¥543 million.

The Company's mainstay business, products for silicon wafers, was affected by the Great East Japan Earthquake, with lapping materials down 20.4%, to ¥2,960 million, and sales of polishing materials down 8.5%, to ¥6,947 million.

Our sales of products for chemical mechanical planarization (CMP) slid 5.9%, to ¥8,029 million, as shipments to device manufacturers declined.

Sales of compounds for hard disks fell 33.5%, to ¥1,788 million, affected by lackluster shipments of conventional personal computers and the effects of the flooding in Thailand.

In the upcoming fiscal year, we expect operating performance to rebound substantially. This anticipation is based on the current state of the semiconductor market, which is beginning to recover, and new demand from non-semiconductor sectors.

The current fiscal year was the third for our nine-year Mid-Long Term Management Plan, marking an end to the first phase, which was positioned as the period for establishing the foundations for growth and



"seeding" our operations. During the year, we integrated our sales and development functions, reorganized our quality assurance department and established a product support office. These restructuring measures were designed to revamp our organization in order to meet customer needs more quickly and precisely.

Recognizing that cultivating human resources is essential to our growth, we launched a human resource educational system reform project. We also concentrated on sowing the seeds of growth with a new business creation project designed to uncover and cultivate businesses that will become future pillars of our operations.

As part of our continued efforts to achieve our corporate vision of becoming a "strong, kind and exciting" company, in the upcoming fiscal year we will commence the second three-year phase of our plan, to "raise the seeds we have planted," and strengthen infrastructure as the next step of our Mid-Long Term Management Plan.

July 2012

Keishi Seki, President

## Profile

Since its founding in 1950, Fujimi Incorporated has continued to chart a course as a manufacturer of synthetic precision abrasives. Drawing on its accumulated expertise and extensive research and development (R&D) capabilities, the Company has expanded from abrasives for optical lenses to a variety of products that deliver the ultraprecise planarization sought by leading-edge high-tech industries. Fujimi's lineup covers the complete spectrum from compounds for silicon wafers and other semiconductor substrates, to chemical mechanical planarization (CMP) products required for multilayered circuits on semiconductor chips and compounds for computer hard disks. Recently, the Company is cultivating new fields, commercializing products for cermet (ceramic-metallic composite) thermal spray materials with dramatically improved impact resistance and polishing compounds for sapphire substrates used in LEDs, which are gaining attention for their role in reducing CO<sub>2</sub> and conserving energy.

## Contents

Message from the President	2
Management Objectives	4
Research and Development Activities	8
Selected Financial Data*	9
Balance Sheets*	13
Statements of Income*	15
Statements of Cash Flows*	16
Corporate Data	17
Stock Information	18

\* Indicated figures are on a consolidated basis.

# 当社の経営方針

## はじめに

当社は「パウダーテクノロジー」を事業領域の基本として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理念を掲げ、創業以来一貫して製品の品質化と安定供給に努めております。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力は変わることが

ありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術水準の高度化に対して、迅速かつ的確に対応し、「顧客満足度を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続き掲げてまいります。

## 企業理念

### 企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

### 経営姿勢

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

### 行動規範

- ・お客様の満足を追求し、その信頼にお応えします。
- ・問題の本質を追究し、迅速かつ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもって行動します。
- ・ひとりひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

## 企業ビジョン

### 事業アイデンティティ

パウダー&サーフェイス分野で世界最高技術を提供し、私たちが理想と考える「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが考える「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、生き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

### 企業文化ビジョン

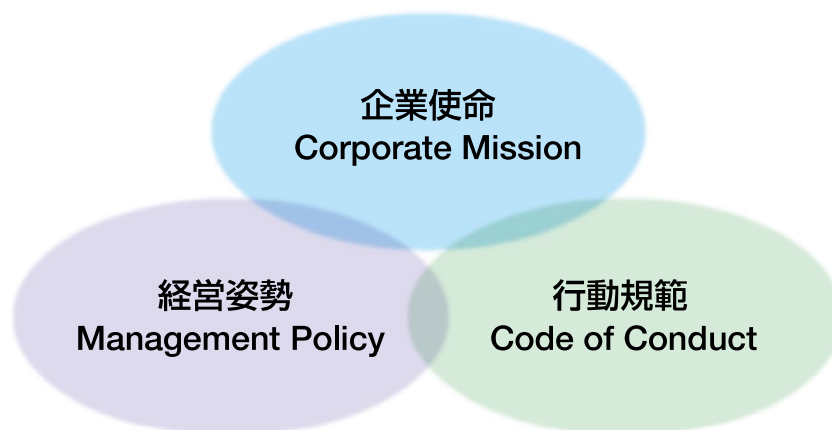
強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切にし、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいだき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

### 事業構造ビジョン

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

## 企業理念 Corporate Philosophy



# Management Objectives

## Introduction

Fujimi has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered on its base in powder technologies. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality

products, a manufacturing approach from which we have never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, “polishing our technologies and bringing people together,” which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain the same.

## Corporate Philosophy

### Corporate Mission

To develop new technologies to meet the needs of high-tech industries, and contribute to the creation of a bright future that is friendly to the earth.

### Management Policy

- We propose original solutions by adopting the viewpoint of the customer.
- To correspond to changes in the business environment, we continue to take on new challenges and make reforms positively.
- We respond to the trust our stakeholders placed in us by improving the quality of our technology and management, and observing the law.

### Code of Conduct

- We seek to satisfy and prove to customers trustworthy.
- We search for the essence of problems and solve them with quickly and with certainty.
- We accept challenge with enthusiasm, honesty and creativity, as we work to achieve our goals.
- We respect and act on individual ideas.
- We will act as a good corporate citizen and maintain a strong sense of ethics.

## Corporate Vision

### Business Identity

We offer the world’s highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an “excellent company.”

Being an “excellent company” means not only having excellent results. It also includes the following.

- Respond to change precisely, and grow continuously.
- Each person works eagerly to achieve the corporate philosophy and vision.
- Contribute to decreasing the environmental impact as a member of a recycling-based society.

### Corporate Cultural Vision

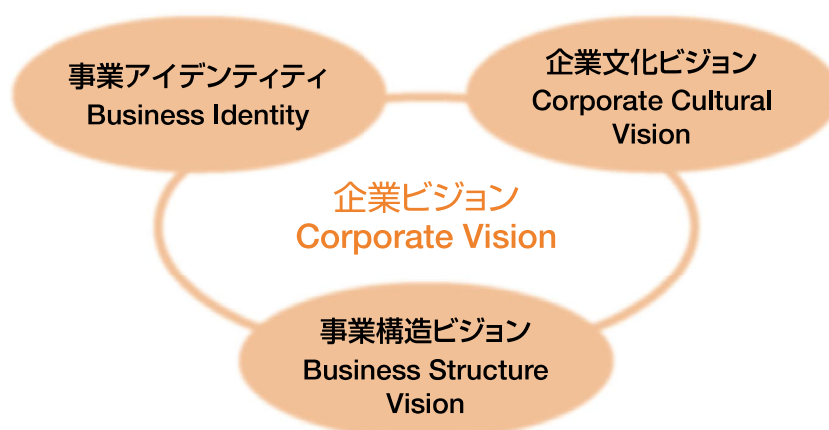
Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)

### Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

### 企業ビジョンの構成 Structure of the Corporate Vision





## 中長期的な会社の経営戦略

当社はバランス・スコアカード (BSC) の考え方を基に、2009年6月に2018年3月期を最終年度とする中長期経営計画を策定いたしました。この中長期経営計画は、3年を区切りとする3次の中期計画を基にして、数値的な定量的な計画だけでなく当社のありたい姿を含めた定性的な計画としています。

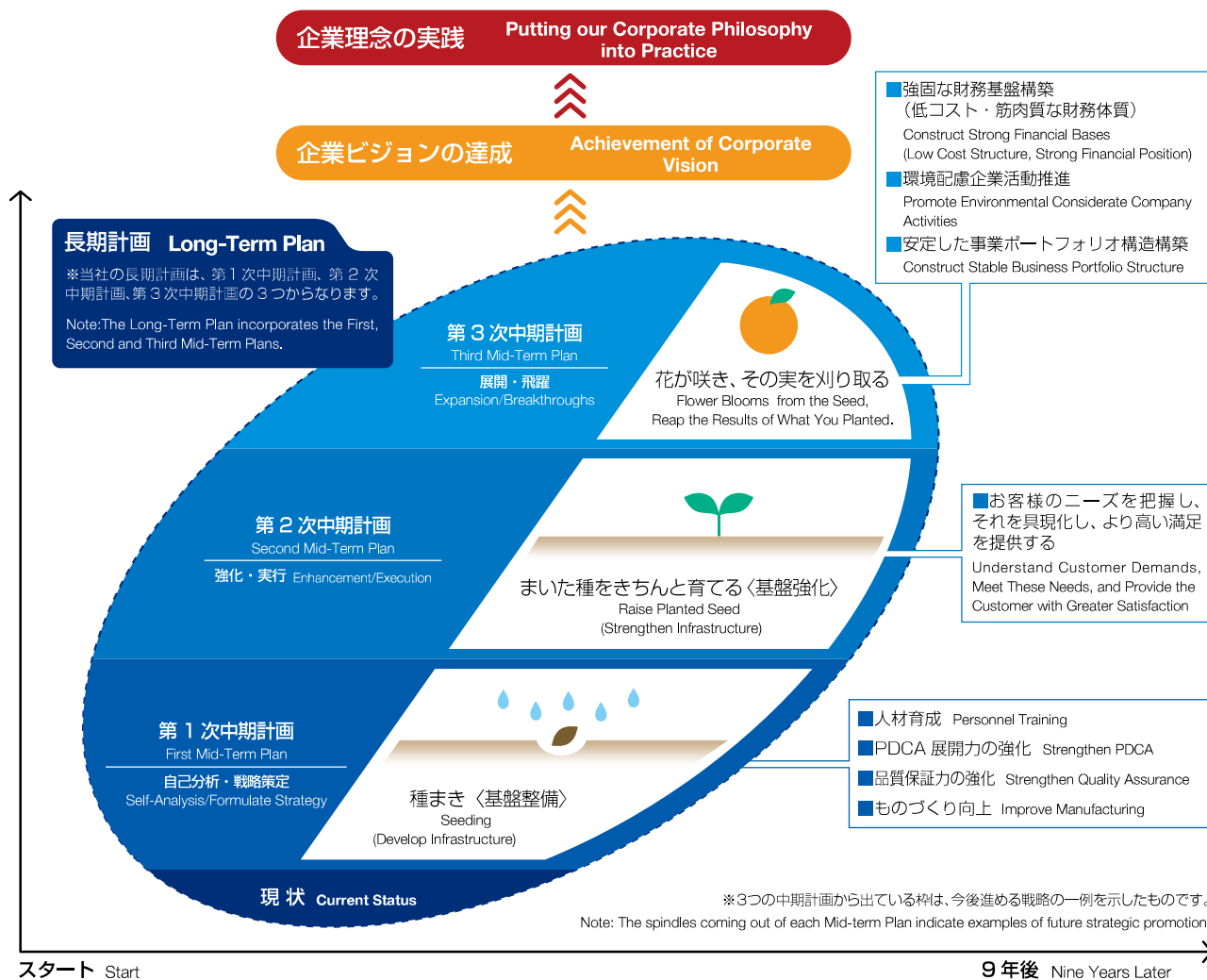
中期計画の第一段階は自己診断と成長のための基礎体力づくり、成長のための種まきにあて、第二段階はまいた種をきちんと育てる時期、そして第三段階は事業開花させ、実を収穫する時期、とそれぞれ位置づけています。

中長期計画の3年目にあたる当期は、第1次中期計画の「種まき〈基盤整備〉」の時期に相当し、「人材育成」「ものづくり向上」「品質保証力の強化」に取り組みました。

今後当社は、経済環境の変化のなかでアグレッシブな成長を目指し、積極果敢にチャレンジしなければならないと考えております。それに加えてどの様な景気変動下にあっても安定的な成長を遂げるため、特定の事業や用途に偏ることがない事業構

造が必要と考えております。そのため従来から推進しているシリコン・CMP・ディスク・機能材・溶射材の5事業に加え、新規事業と新たな用途の探索に継続的にチャレンジし、その実現に向けさまざまな可能性を含めた検討を進めることとしました。具体的には、(1)ろ過・分級、(2)砥粒、(3)ケミカルの3つのコア技術を中心に、技術開発を進め、商品開発の加速、事業のさらなる拡大を推進しております。また、営業と開発を一体化し、市場やお客様のニーズにより迅速かつ確にお応えできるよう組織を再編いたしました。このことを通じて安定した事業構造を維持するため、将来的には事業構造比率として半導体関連比率50%、非半導体関連比率50%を目指しております。

また、全社レベルの目標を事業ごとに戦略目標、施策として具現化し、その成果については評価指標 (KPI) によって四半期ごとに進捗管理するなど、明確な責任体制のもと事業戦略を組織横断的に展開しております。



## Mid-Long Term Management Strategy

Based on its core concept of a Balanced Scorecard (BSC), Fujimi has formulated a Mid-Long Term Management Plan to guide the Company from June 2009 through the fiscal year ending March 31, 2018. The plan is separated into three parts and is based on three successive mid-term plans. In addition to quantifiable objectives, the plan includes qualitative elements that describe the type of organization Fujimi aims to become.

The first stage of our mid-term plan involves self-analysis and establishing the foundations for growth—“seeding” our operations. The second stage involves raising the planted seeds, and at the third stage we plan to reap the results of the seeds of progress we have planted.

This fiscal year was the third year of the first stage, which was the “seeding” phase, and accordingly we have pursued initiatives involving personnel training, improving manufacturing and strengthening quality assurance.

Fujimi understands that achieving its aggressive growth targets in a changing economic environment will require it to take a proactive stance toward upcoming challenges. Furthermore, ensuring stable growth under fluctuating business conditions requires the Company to adjust its business structure along the lines of specific businesses and applications. For this

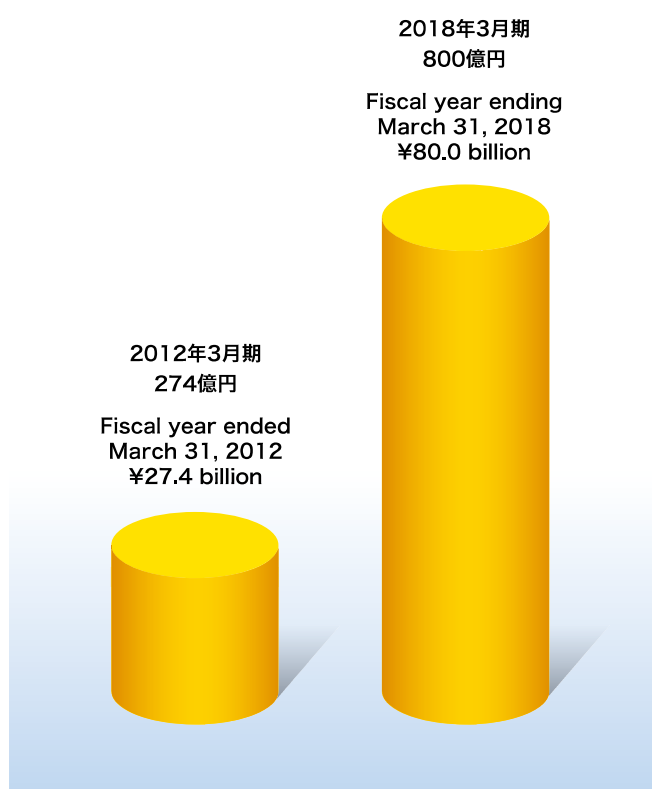
reason, we will continue our search for new businesses and applications in addition to the five areas we have pursued to date (Silicon, CMP, Disk, Specialty materials and Thermal spray materials). We established a specialized section concentrating mainly on three core technologies involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, for promoting technological development, accelerating product development and targeting further business expansion in these areas. Furthermore, we reorganized our business to achieve greater integration between sales and development and enable us to respond more quickly to market demands and the needs of our customers.

Through these efforts, we aim to achieve a business structure in which 50% of our revenues come from semiconductor-related businesses and 50% from non-semiconductor-related businesses.

On a companywide level, we have established strategic targets for the five businesses, by creating specific measures and defining key performance indicators to monitor progress on a quarterly basis. We are deploying operational strategies across the organization, based on a system of clearly defined responsibilities.

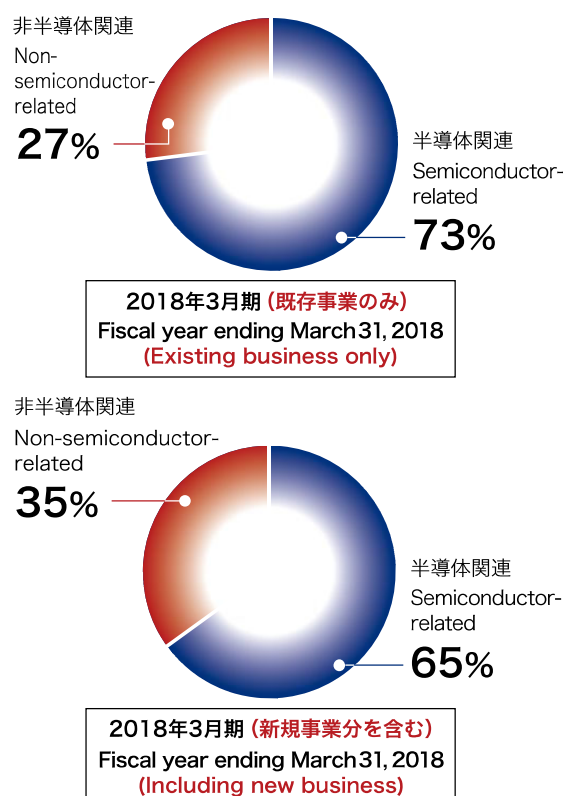
### 中長期経営計画経営目標（売上高）

#### Management Targets of the Mid-Long Term Management Plan (Sales)



### 事業構造ビジョン（売上構成比）

#### Business Structure Vision (Composition of Sales)



# 研究開発活動

当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に積極的に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長のコアとなる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査企画機能の強化に努めています。

## シリコンウェハー

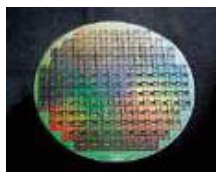
シリコンウェハー 300mm の需要拡大、デザインルールの超微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①平坦化、②無欠陥化、③平滑化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっています。平坦化と生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工精度と加工歩留まり向上のために、砥粒の細粒化に注力しています。



最終仕上げに用いられるポリシング材では、無欠陥化、平滑化、汚染低減への要求がますます強くなっています。22nm デバイス世代のウェハー研磨用として、研磨後表面のナノ欠陥を激減させるポリシング材や、原子レベルの平滑性を実現するポリシング材の開発を推進しています。また、一次研磨工程ではウェハー中心部から外周部まで超平坦に加工できるポリシング材や、生産性向上につながる高速ポリシング材にも、砥粒・添加剤技術を応用しながら開発に取り組んでいます。

## デバイス CMP

先端の半導体デバイスメーカーでは、微細化が進められ技術ノード22nmのLSIが量産開始されました。トランジスタ構造は3Dと呼ばれるように立体化され、メタルゲート等の新たな材料が使われ始めています。こうした先端デバイスでは、その製造工程において、従来以上の沢山のCMPプロセスが使われ、多くの用途のポリシング材が用いられています。



当社では、Cu配線用のポリシング材のみならず、先端デバイスに対応するため、アルミニウム、poly-Si（ポリシリコン薄膜）、SiN（ナイトライド薄膜）、W（タングステン薄膜）用のポリシング材の開発を進めています。微細なデバイスでは、ナノオーダーの平坦化、無欠陥化と言った性能の面だけでなく、品質安定性、コストの面でも従来以上の改善が強く求められており、当社の砥粒技術、ろ過・分級技術、ケミカル技術を活かし、最先端のデバイス製造に応じた研磨装置や表面検査装置の活用によって、お客様のご要望にお応えできるよう開発を進めています。

## ハードディスク

今後増大していくデータ必要量に対応するために、次世代ハードディスクの開発が加速しています。現在、ハードディスク基盤に求められる欠陥・汚染低減への要求はさらに厳しくなっており半導体の表面で求められている欠陥・汚染レベルが必要と



なっています。本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動を実施し新商品の開発を推進しています。

## 機能材

新規事業として、LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品の表面加工分野や、パウダー技術を活かした応用分野への展開に積極的に取り組んでいます。

環境・エネルギー産業分野では、LEDやパワーエレクトロニクス用部品の需要が急増しています。CO<sub>2</sub>削減や省エネで注目を浴びるLED用サファイア基板や、次世代パワーエレクトロニクス用として期待されているGaN・SiC基板は、極めて硬質なために加工に膨大な時間を要しており、製造コスト削減のために加工速度の向上が切望されています。これら硬脆材料基板にダメージを与えることなく、高効率な加工を実現する、研磨・研削材の開発を推進しています。

ディスプレイ産業分野では、ディスプレイの多様な発展を支える各種部品の表面加工材料、レアアース代替研磨材の開発などを推進しています。また、角状ナノアルミナなど、パウダーの特徴を活かした機能材料、光学レンズ用の研削材の開発にも取り組んでいます。

開発企画部門では、当社のコア技術が展開可能な新規分野を、技術と市場の両視点から探索し、新規商品・新規開発テーマの企画を推進しています。

## 基盤技術・生産技術

基盤技術・生産技術部門では当社コア技術のさらなる強化に努めています。①ろ過・分級・精製、②パウダー、③ケミカルの3つのコア技術を中心に技術開発を進め、商品開発の加速、高性能化、新規事業分野への展開に貢献しています。

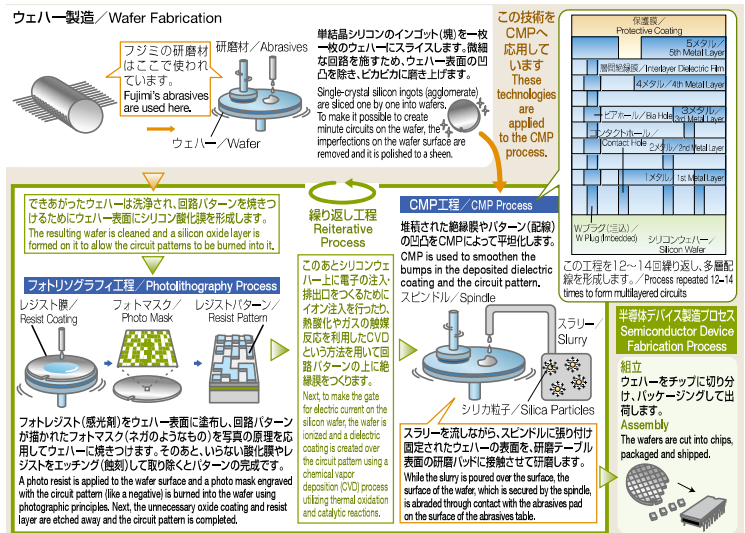
## 溶射材

製造装置・航空機部品用サーメットや電子デバイス・液晶製造装置用セラミックスなどの高付加価値皮膜用溶射材の開発による適用範囲の広がりから、市場規模の拡大が見込まれます。研究開発としては、近年進展が著しい低温溶射法（コールドスプレー、ウォームスプレー）等の新規溶射法に適した溶射材の開発などに重きを置いて推進しています。



## 半導体デバイス製造における CMP の役割

### Role of CMP Processes in Semiconductor Device Fabrication





# Research and Development Activities

As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its aggressive development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks. Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is core to our growth. We are working to strengthen our technology-based new business and topics research and planning function.

## Silicon Wafer Compounds

In accordance with rising demand for 300mm silicon wafers and shrinking design rules, demand is increasing for synthetic precision abrasives that are (1) flat, (2) free from defects and (3) smooth, and that (4) minimize contamination from trace metals and (5) improve manufacturing. We are focused on abrasive grain refinement to improve the processing accuracy and yield rate for lapping and silicon wafer slicing abrasives, which are also required for high-performance flatness and improved manufacturing.

The demand for flat, defect-free, smooth and uncontaminated polishing compounds used in the finishing process are growing stronger. We are developing polishing compounds that will reduce nano defects and achieve the level of smoothness required in polishing next-generation wafers for 22nm devices, as well as polishing compounds that achieve atomic level smoothness. Fujimi is also engaged in the development of abrasives and additive technologies for high-speed polishing compounds, which are linked with productivity increases.

## Device CMP

Semiconductor device manufacturers have commenced mass production of LSIs with increasingly fine 22nm technology nodes. With a physical structure employing 3D transistors, such devices are beginning to employ metal gates and other new materials. The processes used in the manufacture of these leading-edge devices are requiring more CMP processes than ever before, and many of these use polishing compounds.

In addition to polishing compounds for copper wiring, for advanced devices Fujimi has developed compounds for aluminum, as well as polysilicon, silicon nitride and tungsten films. In addition to performance characteristics such as nanometric surface planarity and absence of defects, miniature devices are highlighting the need for stable quality and cost improvements as never before. By leveraging its abrasives, filtration and classification, and chemicals technologies, Fujimi offers the polishing equipment and surface testing devices required to produce leading-edge devices, and we are pursuing development in response to customers' needs.

## Compounds for Hard Disks

The pace of development for next-generation hard disks is accelerating to meet anticipated increases in the volume of data that they will need to handle. Requirements to reduce defects and contamination on hard disk substrates are now approaching the stringent levels demanded for semiconductor

surfaces. To meet these requirements, we are working closely with our customers from the new product development stage.

## Specialty Materials

As new areas of business, we are working vigorously to extend our surface-processing techniques to LED, display and power electronics components, as well as to expand the application of our powder technologies.

In environmental and energy-related fields, demand for LED and power electronics components is surging. Sapphire substrates are used in LEDs, which are heralded for their CO<sub>2</sub> reduction and energy saving effects, and gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) substrates are slated for use in next-generation power devices. As these substrates are extremely hard, processing requires a great deal of time. Accordingly, we are looking earnestly toward ways to increase processing speeds and thereby lower manufacturing costs. We are developing abrasion and polishing compounds that allow these brittle materials to be processed in a highly efficient manner without damaging them.

For the display industry, we are developing surface processing materials for the various components that support multifaceted display development, as well as abrasives that can be used as alternatives to rare earths.

We are also developing functional materials such as angular nanoalumina, whose particle characteristics lend themselves to use in lens polishing.

In planning its new product and development themes, Fujimi's R&D planning section takes a two-pronged approach to determining development targets, as it looks for fields with development potential for the Company's core technologies, as well as promising new technologies and markets.

## Core Technologies, Production Technologies

This section focuses on reinforcing Fujimi's strengths in core technologies. By promoting the development of technologies mainly involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, the section will accelerate product development, target greater functionality and help expand the Company's operations into new fields of business.

## Thermal Spray Materials

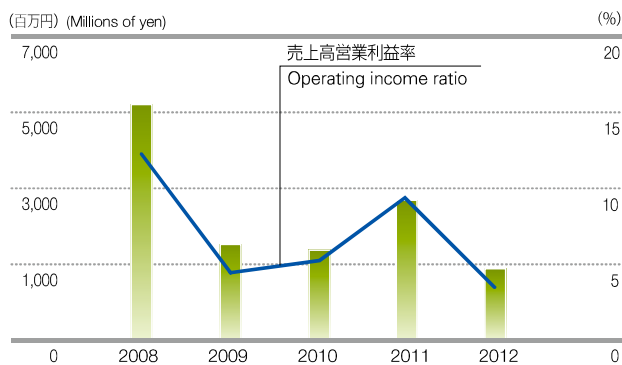
We provide cermet materials for manufacturing equipment and aircraft parts, and are also used to form high-value-added coatings on electronic devices and LCD production equipment, which is expected to expand in scale. We are stepping up our development of thermal spray materials in response to robust recent demand for low-temperature sprays (cold sprays and warm sprays) employed in new thermal spray methods.

# 経営指標 Selected Financial Data

## 収益性 Profitability

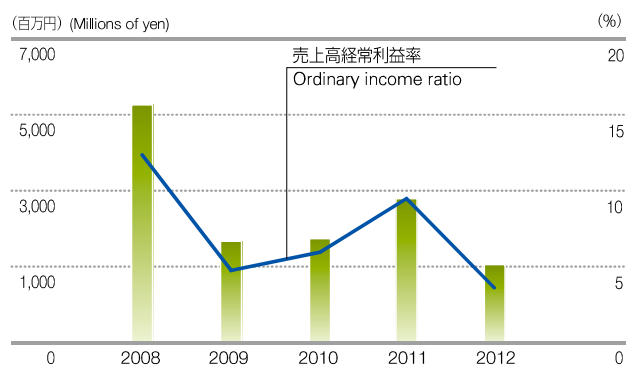
### 営業利益/売上高営業利益率

#### Operating Income and Operating Income Ratio



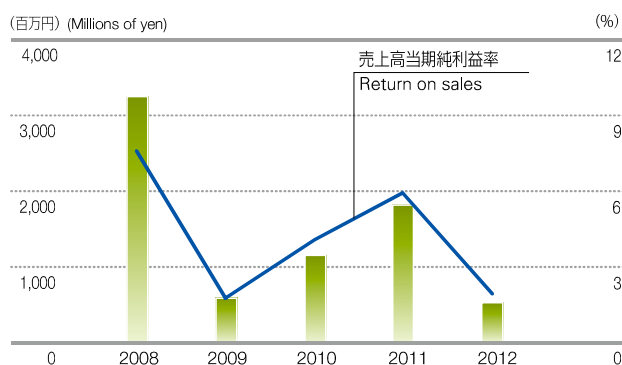
### 経常利益/売上高経常利益率

#### Ordinary Income and Ordinary Income Ratio



### 当期純利益/売上高当期純利益率

#### Net Income and Return on Sales



### 自己資本当期純利益率/総資産利益率

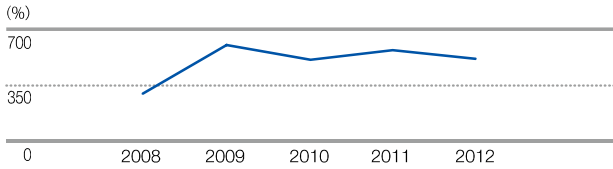
#### Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



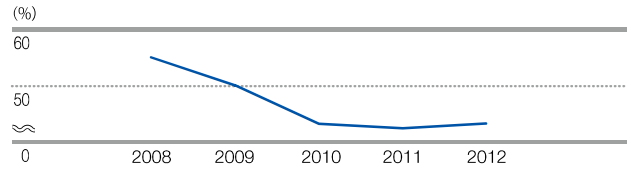
Fiscal years ended March 31				平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
				2008	2009	2010	2011	2012
売上高	(百万円)	Net sales	(Millions of yen)	42,630	34,122	28,177	30,869	27,424
営業利益	(百万円)	Operating income	(Millions of yen)	5,226	1,547	1,496	2,777	953
売上高営業利益率	(%)	Operating income ratio	(%)	12.3	4.5	5.3	9.0	3.5
経常利益	(百万円)	Ordinary income	(Millions of yen)	5,289	1,645	1,699	2,817	1,038
売上高経常利益率	(%)	Ordinary income ratio	(%)	12.4	4.8	6.0	9.1	3.8
当期純利益	(百万円)	Net income	(Millions of yen)	3,249	600	1,161	1,820	543
売上高当期純利益率	(%)	Return on sales	(%)	7.6	1.8	4.1	5.9	2.0
自己資本当期純利益率 (ROE)	(%)	Return on equity	(%)	7.5	1.4	2.8	4.4	1.4
総資産利益率 (ROA)	(%)	Return on assets	(%)	6.0	1.2	2.5	3.9	1.2

## 安定性 Stability

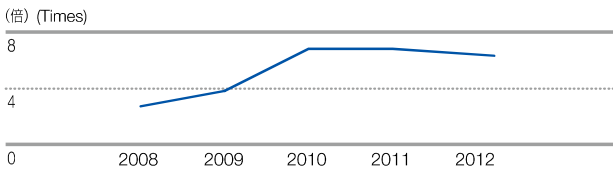
流動比率 Current Ratio



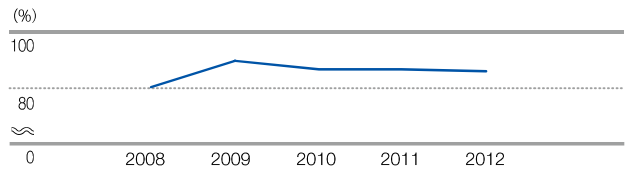
固定比率 Fixed Assets Ratio



手元流動性比率 Short Term Liquidity



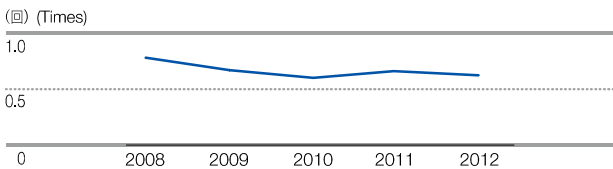
自己資本比率 Equity Ratio



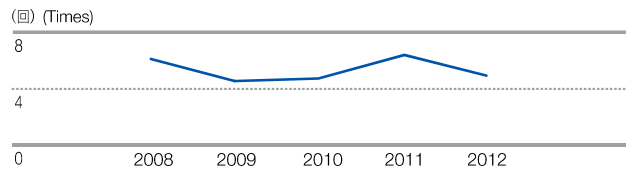
Fiscal years ended March 31				平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
流動比率	(%)	Current ratio	(%)	302.8	606.6	513.8	531.9	516.1
固定比率	(%)	Fixed assets ratio	(%)	55.2	50.2	43.3	40.3	41.4
手元流動性比率	(倍)	Short term liquidity	(Times)	2.8	3.9	6.9	6.9	6.5
自己資本比率	(%)	Equity ratio	(%)	80.3	89.7	86.7	86.7	86.4

## 生産性 / 効率性 Productivity and Efficiency

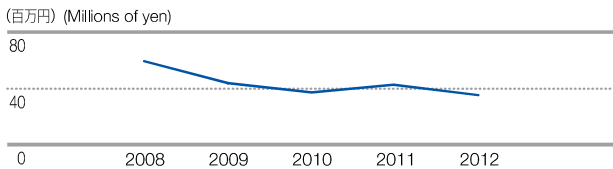
総資産回転率 Asset Turnover



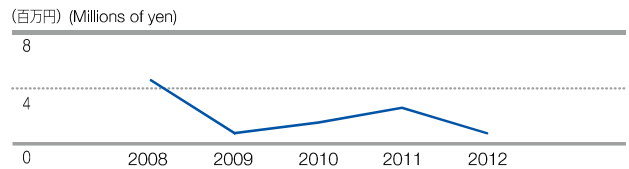
たな卸資産回転率 Inventory Turnover



従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



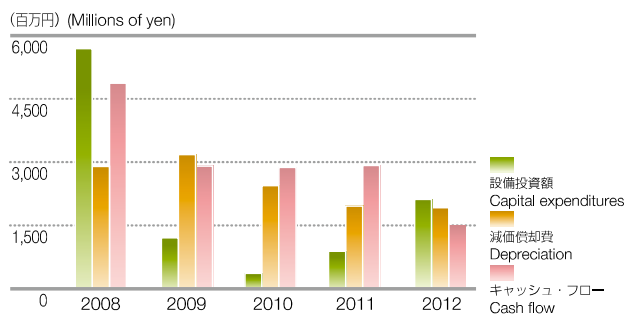
従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee



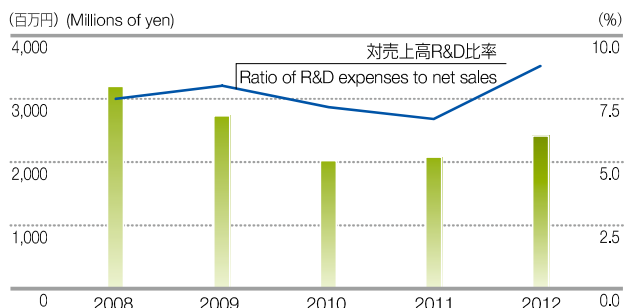
Fiscal years ended March 31				平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
総資産回転率	(回)	Asset turnover	(Times)	0.78	0.67	0.60	0.66	0.62
たな卸資産回転率	(回)	Inventory turnover	(Times)	6.14	4.55	4.73	6.35	4.86
従業員1人当たり売上高	(百万円)	Net sales per employee	(Millions of yen)	59.79	44.00	37.29	41.77	36.08
従業員1人当たり当期純利益	(百万円)	Net income per employee	(Millions of yen)	4.56	0.77	1.53	2.46	0.71
従業員数	(人)	Number of employees		776	775	736	742	760

## 設備投資 / 研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

設備投資額/減価償却費/キャッシュ・フロー  
Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow



研究開発費/対売上高R&D比率  
R&D Expenses and Ratio of R&D Expenses to Net Sales

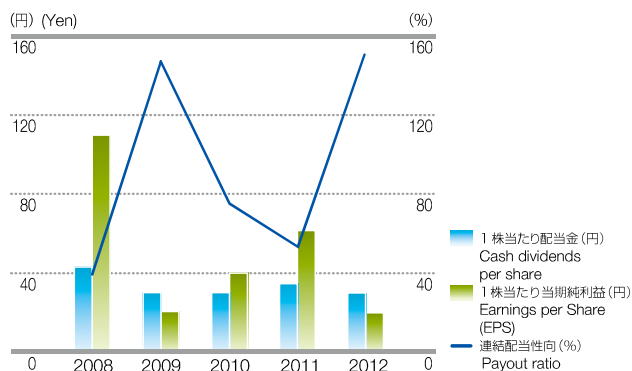


Fiscal years ended March 31				平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
設備投資額	(百万円)	Capital expenditures	(Millions of yen)	5,694	1,207	363	905	2,116
減価償却費	(百万円)	Depreciation	(Millions of yen)	2,899	3,183	2,448	1,991	1,921
キャッシュ・フロー * 1	(百万円)	Cash flow	(Millions of yen)	4,873	2,909	2,880	2,949	1,492
研究開発費	(百万円)	R&D expenses	(Millions of yen)	3,201	2,738	2,025	2,109	2,415
対売上高 R&D 比率	(%)	Ratio of R&D expenses to net sales	(%)	7.51	8.03	7.19	6.83	8.80

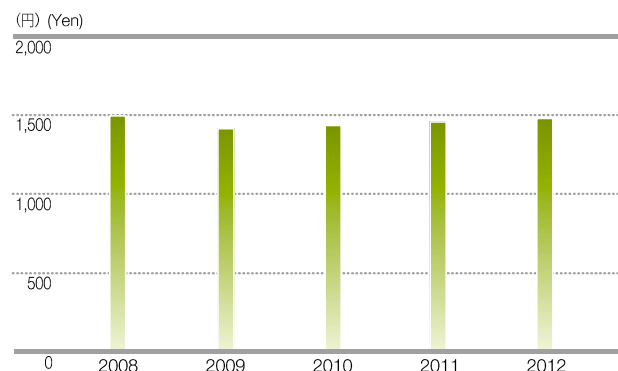
\* 1 キャッシュ・フロー = 当期純利益 + 減価償却費 - 配当金  
Note: Cash flow = Net income + Depreciation - Dividends

## 投資指標 Per Share Data and Others

1株当たり配当金/連結配当性向  
Cash Dividends per Share, Payout Ratio  
1株当たり当期純利益  
Earnings per Share (EPS)



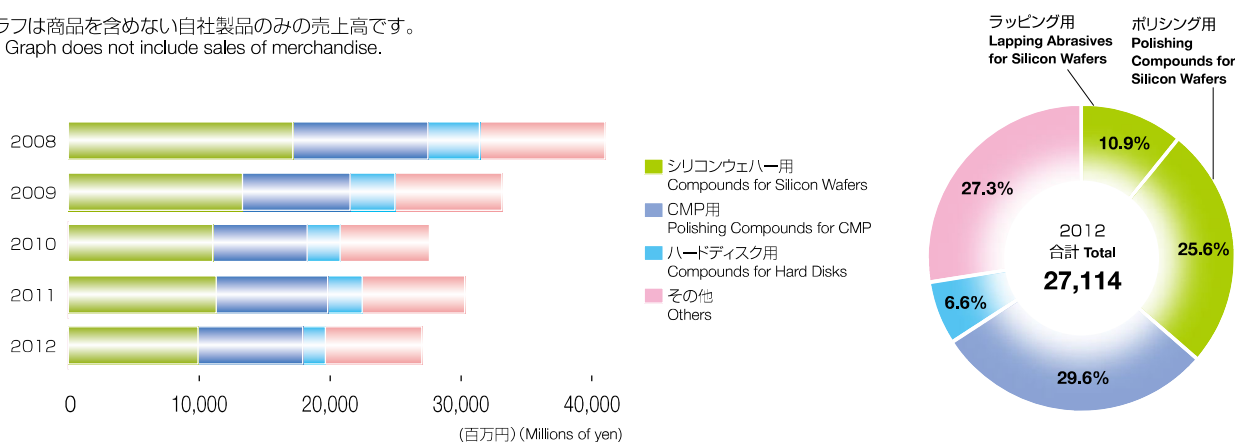
1株当たり純資産  
Book-value per Share (BPS)



Fiscal years ended March 31				平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
1株当たり配当金	(円)	Cash dividends per share	(Yen)	43.00	30.00	30.00	35.00	30.00
連結配当性向	(%)	Payout ratio	(%)	39.2	146.8	75.0	54.8	150.7
1株当たり当期純利益 (EPS)	(円)	Earnings per share	(Yen)	109.64	20.44	39.98	63.82	19.91
1株当たり純資産 (BPS)	(円)	Book-value per share	(Yen)	1,494.76	1,413.55	1,432.59	1,450.83	1,478.56

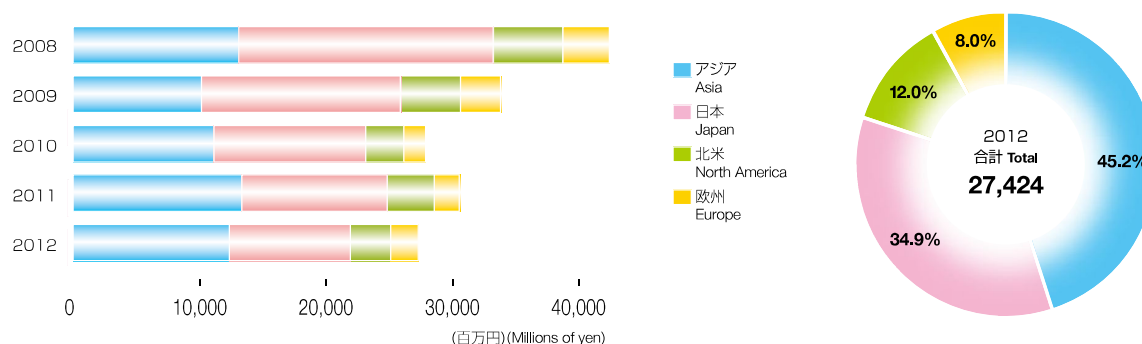
## 用途別製品売上高 Sales by Application

\* グラフは商品を含めない自社製品のみでの売上高です。  
Note: Graph does not include sales of merchandise.



Fiscal years ended March 31 (百万円) (Millions of yen)		平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
シリコンウェハー用	Compounds for Silicon Wafers	17,133	13,296	11,037	11,314	9,907
CMP用	Polishing Compounds for CMP	10,370	8,266	7,262	8,532	8,029
ハードディスク用	Compounds for Hard Disks	4,000	3,469	2,570	2,689	1,788
その他	Others	9,620	8,265	6,854	7,868	7,388

## 地域別売上高 Sales by Region



Fiscal years ended March 31 (百万円) (Millions of yen)		平成20年3月期 2008	平成21年3月期 2009	平成22年3月期 2010	平成23年3月期 2011	平成24年3月期 2012
アジア	Asia	13,169	10,238	11,256	13,469	12,389
日本	Japan	20,247	15,838	12,076	11,579	9,568
北米	North America	5,526	4,843	3,126	3,829	3,282
欧州	Europe	3,687	3,202	1,718	1,990	2,183
合計	Total	42,630	34,122	28,177	30,869	27,424



# 貸借対照表

## Balance Sheets

(百万円) (Millions of yen)

As of March 31		平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
<b>資産の部</b>	<b>Assets</b>					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and cash equivalents	6,307	10,095	13,835	12,468	9,490
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable	12,195	5,912	8,027	6,820	6,504
有価証券	Marketable securities	3,221	103	2,303	5,303	5,301
たな卸資産	Inventories	7,742	7,244	4,676	5,048	6,241
繰延税金資産	Deferred tax assets	640	236	751	632	434
短期貸付金	Short-term loans receivable	303	802	2	3	4
その他の流動資産	Other current assets	351	1,062	130	276	570
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(12)	(197)	(110)	(157)	(41)
流動資産合計	Total current assets	30,747	25,260	29,617	30,396	28,506
固定資産	Fixed assets					
有形固定資産	Tangible fixed assets					
建物及び構築物	Buildings and structures	9,018	8,297	7,568	6,963	6,782
機械装置及び運搬具	Machinery and equipment	5,147	4,496	3,181	2,345	2,062
土地	Land	3,448	3,428	3,400	3,391	3,392
その他の有形固定資産	Other tangible fixed assets	2,842	1,462	1,088	1,218	1,732
有形固定資産合計	Total tangible fixed assets	20,456	17,685	15,239	13,919	13,970
無形固定資産	Intangible fixed assets	425	363	331	305	462
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment in securities	314	184	253	98	99
長期貸付金	Long-term loans receivable	2	1	1	3	4
繰延税金資産	Deferred tax assets	384	360	82	95	48
その他の投資その他の資産	Other investments and assets	2,910	2,121	1,954	1,925	1,488
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(8)	(8)	(16)	(9)	(199)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	3,604	2,659	2,273	2,113	1,442
固定資産合計	Total fixed assets	24,485	20,708	17,844	16,338	15,875
資産合計	Total assets	55,233	45,969	47,462	46,734	44,381

(百万円) (Millions of yen)

		As of March 31				
		平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
<b>負債の部</b>		<b>Liabilities</b>				
流動負債		Current liabilities				
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable	5,185	2,414	3,335	2,905	3,082
短期借入金	Short-term borrowings	720	145	184	81	41
未払法人税等	Corporate tax payable	793	76	476	476	14
賞与引当金	Allowance for bonuses payable	570	368	456	595	612
その他の流動負債	Other current liabilities	2,884	1,159	1,310	1,655	1,773
流動負債合計	Total current liabilities	10,154	4,164	5,763	5,714	5,523
固定負債		Fixed liabilities				
長期借入金	Long-term borrowings	429	250	161	61	—
退職給付引当金	Allowance for employees' retirement benefits	89	85	98	120	147
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	13	7	5	8	33
その他	Other fixed liabilities	10	9	5	27	32
固定負債合計	Total fixed liabilities	543	352	271	217	214
負債合計	Total liabilities	10,697	4,517	6,035	5,932	5,737
<b>純資産の部</b>		<b>Net assets</b>				
資本金	Common stock	4,753	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	5,070	5,070	5,069	5,069	5,069
利益剰余金	Retained earnings	35,344	34,679	35,111	36,069	35,716
自己株式	Treasury stock	(1,349)	(2,104)	(2,764)	(3,792)	(5,711)
株主資本合計	Total shareholders' equity	43,818	42,398	42,170	42,100	39,828
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	522	(1,162)	(998)	(1,565)	(1,475)
新株予約権	Subscription rights to shares	11	44	63	61	59
少数株主持分	Minority interests	183	172	191	205	231
純資産合計	Total net assets	44,536	41,451	41,426	40,802	38,643
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	55,233	45,969	47,462	46,734	44,381

# 損益計算書

## Statements of Income

(百万円) (Millions of yen)

Fiscal years ended March 31		平成20年 3月期 2008	平成21年 3月期 2009	平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012
<b>経常損益の部</b>	<b>Ordinary income and expenses</b>					
営業損益の部	Operating income and expenses					
売上高	Net sales	42,630	34,122	28,177	30,869	27,424
売上原価	Cost of sales	29,429	25,178	20,573	21,362	19,399
売上総利益	Gross profit	13,201	8,943	7,604	9,506	8,024
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	7,975	7,396	6,107	6,729	7,070
営業利益	Operating income	5,226	1,547	1,496	2,777	953
営業外損益の部	Non-operating income and expenses					
受取利息	Interest income	102	90	50	54	60
受取配当金	Dividend income	4	4	2	2	2
その他の営業外収益	Other nonoperating income	74	87	174	68	72
営業外収益	Non-operating income	181	183	225	125	136
支払利息	Interest expenses	49	47	16	12	5
その他の営業外費用	Other nonoperating expenses	68	37	6	72	46
営業外費用	Non-operating expenses	118	85	22	85	51
経常利益	Ordinary income	5,289	1,645	1,699	2,817	1,038
<b>特別損益の部</b>	<b>Extraordinary items</b>					
固定資産売却益	Proceeds from sales of fixed assets	1	3	1	3	2
補助金収入	Subsidy income	33	36	—	—	—
その他の特別利益	Other extraordinary income	61	18	219	51	3
特別利益	Extraordinary income	96	58	220	54	6
固定資産除売却損	Loss on disposal of fixed assets	49	54	45	65	15
投資有価証券評価損	Loss on revaluation of investment securities	—	30	—	22	—
減損損失	Impairment loss	284	90	403	—	—
その他の特別損失	Other extraordinary losses	54	136	3	19	48
特別損失	Extraordinary losses	388	312	452	107	63
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	4,997	1,392	1,467	2,764	980
法人税、住民税及び事業税	Income taxes—current	1,934	304	546	828	157
法人税等調整額	Income taxes—deferred	(224)	448	(255)	97	260
少数株主利益	Minority interest in earnings of consolidated subsidiaries	37	38	14	17	19
当期純利益	Net income	4,080	3,249	600	1,820	543

# キャッシュ・フロー計算書

## Statements of Cash Flows

(百万円) (Millions of yen)

		平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
Fiscal years ended March 31		2008	2009	2010	2011	2012
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from operating activities</b>					
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	4,997	1,392	1,467	2,764	980
減価償却費	Depreciation and amortization	2,899	3,183	2,448	1,991	1,921
減損損失	Impairment loss	284	90	403	—	—
固定資産除売却損益 (益)	Loss (gain) on sale or disposal of fixed assets	47	50	43	62	12
売上債権増減額 (増加)	(Increase) decrease in receivables	538	5,777	(2,081)	1,036	130
仕入債務増減額 (減少)	Increase (decrease) in payables	(149)	(2,140)	856	(289)	26
たな卸資産増減額 (増加)	(Increase) decrease in inventories	(1,676)	(359)	2,656	(561)	(1,161)
その他	Others	(84)	(250)	149	110	86
小計	Subtotal	6,856	7,743	5,944	5,115	1,996
利息及び配当金の受取額	Interest and dividends received	104	89	51	68	64
補助金の受取額	Income from new industry subsidies	23	33	99	—	—
事業撤退に伴う収入	Income from withdrawal from business	—	—	32	—	—
事業撤退による支出	Payments for withdrawal from business	—	(17)	—	—	—
利息の支払額	Interest paid	(45)	(48)	(16)	(13)	(5)
法人税等の支払額	Income taxes paid	(2,325)	(1,814)	(135)	(837)	(892)
法人税等の還付額	Income taxes refunded	—	—	791	9	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents provided by operating activities	4,613	5,986	6,768	4,342	1,162
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from investing activities</b>					
定期預金の預入による支出	Payments for additions to fixed deposits	(500)	—	(1,500)	(1,505)	(2,615)
定期預金の払戻による収入	Income from withdrawal of fixed deposits	500	800	150	1,500	2,508
有価証券の増減額 (減少)	(Increase) decrease in marketable securities	(99)	—	99	108	—
有価証券の取得による支出	Payment for acquisition of securities	—	—	—	—	(800)
有形固定資産取得による支出	Purchase of tangible fixed assets	(6,046)	(2,382)	(256)	(508)	(1,707)
その他	Others	(225)	8	(87)	(65)	(262)
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents used in investing activities	(6,371)	(1,573)	(1,594)	(471)	(2,876)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from financing activities</b>					
短期借入金の純増減額 (減少)	Increase (decrease) in short-term borrowings	288	(487)	37	(87)	—
長期借入による収入	Proceeds from long-term loans payable	559	—	—	—	—
長期借入金の返済による支出	Expenses from repayment of long-term borrowings	(1)	(106)	(93)	(87)	(79)
自己株式の取得及び売却による収支	Proceeds from sales of (payments for purchase of) treasury stock	104	(755)	(675)	(1,028)	(1,918)
親会社による配当金の支払額	Payment of dividends by the parent company	(1,273)	(1,265)	(729)	(862)	(971)
その他	Others	—	(4)	10	(7)	(11)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents used in financing activities	(321)	(2,618)	(1,450)	(2,073)	(2,980)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and equivalents	23	(624)	17	(171)	(146)
現金及び現金同等物の増加 (減少) 額	Increase (decrease) in cash and cash equivalents	(2,055)	1,169	3,740	1,626	(4,841)
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of year	11,785	9,729	10,899	14,639	16,265
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	Increase (decrease) in cash/cash-equivalent transactions due to changes in the accounting period of affiliated	—	—	—	—	155
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of year	9,729	10,899	14,639	16,265	11,579

# 会社データ Corporate Data

商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年(昭和28年)3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384
従業員数 Number of employees	760 (個別 Non-Consolidated 588)

## 役員 Board of Directors

2012年(平成24年)6月22日現在 (As of June 22, 2012)

代表取締役社長 President	関 敬史 Keishi Seki
常務取締役 Director	伊藤 広一 Hirokazu Ito
取締役 Director	土屋太加志 Takashi Tsuchiya
取締役 Director	鈴木 彰 Akira Suzuki
取締役 Director	大脇 寿樹(新任) Toshiki Owaki
取締役 Director	鈴木 勝弘(新任) Katsuhiro Suzuki
常務監査役 Standing Corporate Auditor	石井 和廣 Kazuhiro Ishii
常務監査役 Standing Corporate Auditor	松島 伸男 Nobuo Matsushima
監査役 Corporate Auditor	高橋 正彦 Masahiko Takahashi
監査役 Corporate Auditor	川下 政美(新任) Masami Kawashita

## 事務所・拠点 Plants and Offices

本社・枇杷島工場 Headquarters・Biwajima Plant  
〒452-8502  
愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1  
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166  
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi,  
452-8502, Japan  
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

稲沢工場 Inazawa Plant  
〒492-8329  
愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1  
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa, Aichi,  
492-8329, Japan

各務原工場 Kakamigahara Plant  
〒504-0927  
岐阜県各務原市上戸町 7-1-8  
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara, Gifu,  
504-0927, Japan

各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant  
〒509-0103  
岐阜県各務原市各務東町 5-62-1  
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu,  
509-0103, Japan

溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department  
〒509-0103  
岐阜県各務原市各務東町 5-82-28  
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu,  
509-0103, Japan

研究開発センター R&D Center  
〒509-0109  
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8  
8, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu,  
509-0109, Japan

物流センター Logistics Center  
〒509-0109  
岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1  
1, Technoplaza-4, Kakamigahara, Gifu,  
509-0109, Japan

東京営業所 Tokyo Office  
〒101-0047  
東京都千代田区内神田 3-2-8 COI 内神田ビル 7F  
7th Floor, COI Uchikanda Bldg., 2-8,  
Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,  
101-0047, Japan

台湾事務所 Taiwan Office  
新竹縣 302 竹北市縣政九路 215 號 4 樓  
4th Floor, No. 215, Shian-Jheng 9th Rd.,  
Jubei City, Hsinchu Hsien 302 Taiwan, ROC

上海事務所 Shanghai Office  
上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室  
317B, German Center, 88 Keyuan Road,  
Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203, Shanghai, China

韓国事務所 Korea Office  
RM. 3032, 30th floor, ASEM Tower, 159-1, Samsung-Dong,  
Gangnam-Gu, Seoul

## 関連会社 Affiliated Companies

フジミコーポレーション(米国)  
FUJIMI CORPORATION  
11200 SW Leveton Drive, Tualatin,  
Oregon 97062, U.S.A.  
Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

フジミマイクロテクノロジー(マレーシア)  
FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.  
Unit 3, Level 15, Menara Genesis No. 33,  
Jalan Sultan Ismail 50250, Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone: +60-3-2143-0036 Fax: +60-3-2145-8955

フジミヨーロッパ(ドイツ)  
FUJIMI EUROPE GmbH  
Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany  
Phone: +49-7940-58402 Fax: +49-7940-57611

フジミ台湾(台湾)  
FUJIMI TAIWAN LIMITED  
Rm. A02, 1F., No.1, Lixing 1st Rd., East Dist.,  
Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)  
Phone: +886-3-666-3835



# 株式情報 Stock Information

## 大株主一覧 Leading Shareholders

2012年(平成24年)3月31日現在 (As of March 31, 2012)

株主名 Name of Shareholder		所有株式数 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 (%) Percentage of Total
株式会社フジインコーポレーテッド(自己株口)	Fujimi Incorporated (Treasury Stock)	4,760	15.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	2,902	9.4
有限会社コマ	Koma Co., Ltd.	1,638	5.3
野田 純孝	Sumitaka Noda	1,520	4.9
越山 彰	Akira Koshiyama	1,151	3.7
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	779	2.5
株式会社三菱東京UFJ銀行	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.3
ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)	Northern Trust Co. (AVFC)		
サブ アカウント アメリカン クライアント	Sub A/C American Clients	728	2.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	711	2.3
株式会社りそな銀行	Resona Bank, Ltd.	691	2.2

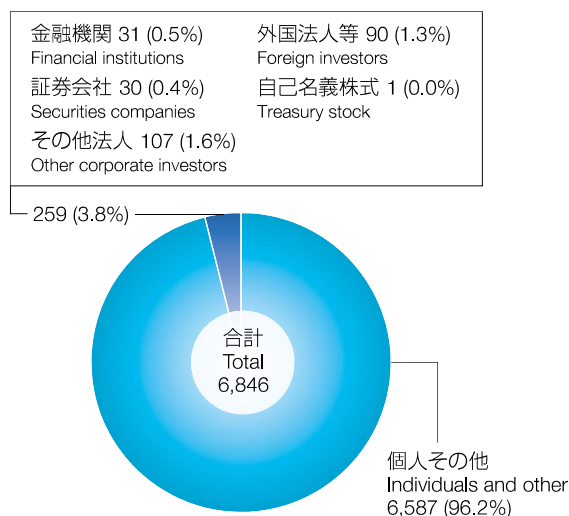
(注) 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てしています。

Note: Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is rounded off after the first decimal place.

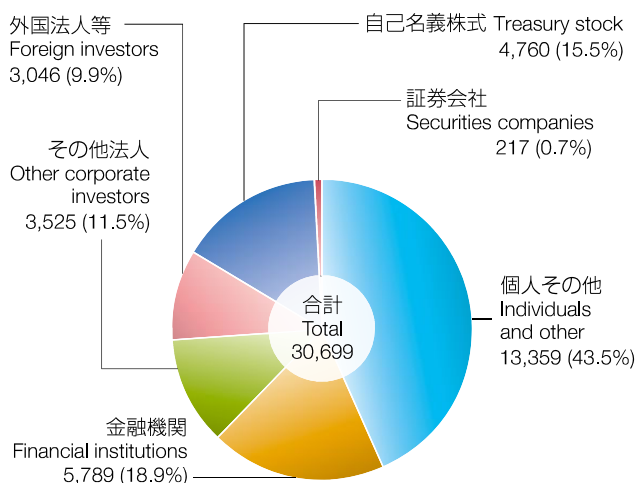
## 所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

2012年(平成24年)3月31日現在 (As of March 31, 2012)

所有者別株主数(人)  
Shareholders by Category (Number of Shareholders)



所有者別持株数(千株)  
Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)



## 発行済株式の推移 Common Stock Issues

発行済株式数(千株) Shares Outstanding after Issue (Thousands of Shares)	摘要 Type of Issue	
245	第三者割当増資	Allotment of new shares to third parties
491	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split
509	新株引受権の権利行使	Exercise of warrants
1,019	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split
10,195	500円額面株式1株を50円額面株式10株に分割	Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500
10,995	一般公募増資	Public offering of common stock
12,094	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split
12,894	一般公募増資	Public offering of common stock
14,184	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split
15,602	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split
15,349	自己株式の利益消却	Treasury stock purchased and retired
30,699	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split

# FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド



この印刷物は、環境負荷低減のため適切に管理された古紙パルプを5%以上使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。

To reduce environmental impact, this publication was printed on environmentally responsible paper made with appropriately managed recycled pulp content of 5% or more, using vegetable ink to reduce emissions of volatile organic compounds (VOCs).

Copyright (C) 2012 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

Printed in Japan